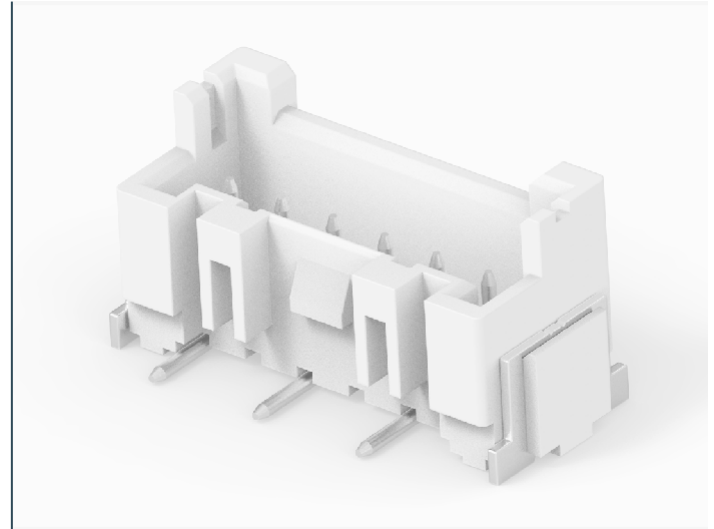


新製品紹介

エコノミー・パワー EP2.5 表面実装用ヘッド

- 基板の自動アセンブリをサポート
- 既存のEP2.5mmコネクタにも使用可能
- 各種グローバル安全規格に準拠



EP2.5 (エコノミーパワー2.5) 表面実装技術 (SMT) ヘッドは、自動組立工程を使用する基板メーカーが、コンパクトな電線対基板コネクタを使用するのに適したソリューションです。本製品は、チップマウンターによる自動組立やリフローによるはんだ付けなど、より効率的な基板製造工程をサポートし、既存のEP2.5mmピッチシリーズ製品にも使用可能であり、お客様の設計に更なる柔軟性を提供します。

アプリケーション

- 大型・小型生活家電品
- HVAC
- インダストリアル機器
- 自動組立装置
- 照明機器
- 自動車

詳細

- [製品ページ](#)
- [フライヤー](#)

主な特長

- 表面実装技術 (SMT) により、チップマウンターによる自動組立やリフローによるはんだ付けをサポートします。
- スルーホールヘッドと比較して、はんだブリッジによる接続不良のリスクを低減します。
- 既存のEP 2.5コネクタや類似の2.5mmピッチ製品との嵌合が可能です。
- UL 94 V-0およびIEC 60335-1グローワイヤテスト (GWT) の難燃規格に適合した材料です。
- ULおよびVDE認証